

# Nanotek Brush

ナノテクブラシ



## ナノテクブラシの特徴

IC パッケージのファイナルテスト現場では、BGA や CSP・ハンダコーティングされたパッドを持つ QFN などのハンダ主成分であるスズが IC ソケットに付着・転移することで、イールドダウンすることがあります。これは IC ソケットに付着したスズが酸化し、電気検査に悪影響を及ぼした結果です。

喜多製作所のナノテクブラシは IC ソケットに組み込まれたプローブ等に付着・転移したハンダくずを効果的に取り除く事ができるオリジナル製品です。

ブラシには極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細かい谷部への入り込み効果を生み出します。全体が金属製であることでブラッシングによる帯電を抑制する効果も兼ね備える製品です。

## 使用方法

プローブを IC ソケットから取り外すことなく、そのままナノテクブラシで 10 回から 20 回程度ブラッシングするだけで、以下の写真のようにこびりついていたハンダが除去されます。

※ブラッシングによりメッキ等にダメージを与える場合があります。あまり強くブラッシングしすぎないようにご注意ください。

## プローブ先端写真(ブラシ使用例)

ハンダ・フラックスが付着



真上からの写真



ブラッシング  
20 回  
使用ブラシ  
NANO-5-003

簡単に付着物を除去



真上からの写真



## 用途

- ◆ IC ソケットのメンテナンス (プローブタイプ、板バネタイプ)
- ◆ モールディング時の金型内の固形異物の除去

## メリット

- ◆ コンタクト改善時間の短縮
- ◆ 部分的なクリーニングが可能
- ◆ 薬品での洗浄より大幅に短い作業時間と低いコスト
- ◆ 優れた携帯性で突発的な応急対応作業に最適
- ◆ 線毛がしなやかで細く、クラウン形状の細い先端の谷間の汚れに届く
- ◆ 樹脂線毛にはないステンレス線の強度、硬度でこれまで取れなかった汚れにも効果的